

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和7年5月21日(2025.5.21)

【国際公開番号】WO2023/136253

【出願番号】特願2023-574042(P2023-574042)

【国際特許分類】

H 01 L 23/14(2006.01)

H 05 K 1/03(2006.01)

【F I】

10

H 01 L 23/14 R

H 05 K 1/03 610H

【手続補正書】

【提出日】令和7年5月13日(2025.5.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0179

【補正方法】変更

【補正の内容】

20

【0179】

<界面ボイドの評価>

(1)樹脂シートの積層

実施例及び比較例で作製した樹脂シートを、シート貼り付け装置を用いて、樹脂組成物層が基材と接合するように、基材の片面に積層した。比較例1においては、樹脂組成物層と基材とを接合させた後、処理対象の樹脂シートと基材が格納されるチャンバ内を減圧して雰囲気圧力を13 hPa以下とした。他方、実施例1～8及び比較例2においては、処理対象の樹脂シートと基材が格納されるチャンバ内を減圧して雰囲気圧力を13 hPa以下とした後に、樹脂組成物層と基材とを接合させた。そして温度100℃、圧着圧力0.5 MPaにて100秒間圧着することにより樹脂シートを基材に積層した。

30

40

50